



# 筑波深耕無線通訊測試 跨足半導體

新設半導體EC工程中心，並與自動測試設備大廠Teradyne美商泰瑞達合作



文 / 李其芳

日前聯發科發表行動平台「天璣 1050」，支援5G毫米波及Sub-6GHz全頻段5G網路，並且提供更長的電池續航力，終端產品預計於Q3上市。此舉無疑為市場打了一劑強心針，但是5G毫米波普及還存在許多挑戰，何時會有突破性的發展，仍然是未知數。

筑波科技營運長許棟材

●筑波科技營運長許棟材認為，國內已有完整的5G生態系，具備發展5G毫米波的優勢，就等待技術上的突破。

圖 / 筑波科技提供

以系統測試方案商的角度提出看法：「5G目前以FR1 Sub-6為主，FR2毫米波的部分，3GPP Release 17 (Rel-17) 擴展了FR2-2：52.6G~71GHz的新頻率，但目前仍處於研發或是定點的試量產階段。5G毫米波技術性問題有待克服，未來新興技術像是B5G (Beyond 5G)、低軌道衛星，都有可能替代它的應用。」

許棟材進一步表示：「系統測試從5G、B5G到6G，也逐步往次太赫茲 (sub-THz, 100GHz) 的頻段發展，至於5G毫米波則是跟著3GPP的規範走，並在開發階段就導入最新版本。筑波科技以升降頻器的方案，協助業界的夥伴沿用原有設備，在較短的時間內，以可負擔的成本進行升級，未來產品上市也能維持好的競爭優勢。」

筑波科技深耕無線通訊系統測試逾20年，經營有成，近年更成立半導體事業部，聚焦第三代半導體及化合物半導體量測，該公司上月新設立半導體EC工程中心，並宣布與自動測試設備大廠Teradyne美商泰瑞達展開合作，藉由雙方技術能量加乘，協助客戶在高階功率IC及模組往車用、綠能等應用領域發展。